

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 7 月 13 日 (2017.7.13)

【公開番号】特開 2016-72372 (P2016-72372A)

【公開日】平成 28 年 5 月 9 日 (2016.5.9)

【年通号数】公開・登録公報 2016-027

【出願番号】特願 2014-198804 (P2014-198804)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/30 (2012.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 L

B 2 4 B 37/04 V

H 0 1 L 21/68 P

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 5 月 31 日 (2017.5.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 7】

押し上げ機構 77 は、リテーナリング 3 に接触する押し上げピン 78 と、押し上げピン 78 を上方に押す押圧機構としてのばね（図示せず）と、押し上げピン 78 およびばねを収容するケーシング 79 とを備えている。押し上げ機構 77 は、押し上げピン 78 がリテーナリング 3 の下面に対向する位置に配置される。研磨ヘッド 1 が下降すると、リテーナリング 3 の下面が押し上げピン 78 に接触する。ばねは、リテーナリング 3 を押し上げるのに十分な押圧力を有している。したがって、図 6 に示すように、リテーナリング 3 は押し上げピン 78 に押し上げられ、ウェーハ W よりも上方の位置まで移動される。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 9】

次に、リテーナリングステーション 75 と搬送ステージ 76 を用いたウェーハリリース動作について説明する。研磨されたウェーハ W を保持している研磨ヘッド 1 は、リテーナリングステーション 75 の上方の所定位置に移動する。次いで、研磨ヘッド 1 が下降し、図 6 に示すようにリテーナリング 3 がリテーナリングステーション 75 の押し上げ機構 77 により押し上げられる。研磨ヘッド 1 が下降しているとき、搬送ステージ 76 が上昇し、リテーナリング 3 に接触することなく研磨ヘッド 1 の真下まで移動する。